

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) Nº de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 816 447

(21) Nº d'enregistrement national : 00 14247

(51) Int Cl⁷ : H 01 L 27/16, H 04 N 5/33

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 07.11.00.

(30) Priorité :

(43) Date de mise à la disposition du public de la
demande : 10.05.02 Bulletin 02/19.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du
présent fascicule

(60) Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

(71) Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Etablissement de caractère scientifique technique et industriel — FR.

(72) Inventeur(s) : OUVRIER BUFFET JEAN LOUIS,
BISOTTO SYLVETTE et CAPLET STEPHANE.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : BREVATOME.

(54) DISPOSITIF DE DETECTION DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES TRIDIMENSIONNEL ET
PROCEDE DE REALISATION DE CE DISPOSITIF.

(57) L'invention concerne un dispositif de détection de rayonnements électromagnétiques comprenant au moins un circuit de détection comprenant un détecteur thermique non-refroidi (4) et un circuit de lecture associé (2), caractérisé en ce qu'il comporte :

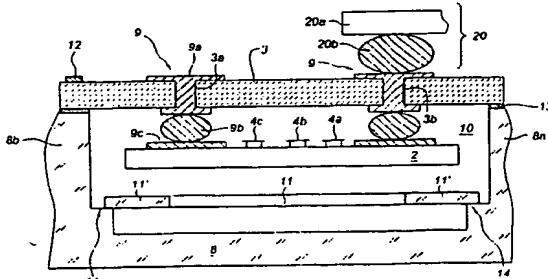
- un substrat (8) formant une cavité sous-vide (10), dans laquelle sont placés le détecteur thermique et le circuit de lecture ;

- une fenêtre (3) transparente aux rayonnements, placée au-dessus de la cavité et assurant la fermeture de celle-ci ;

- des moyens de fermeture (12, 13) pour fixer hermétiquement la fenêtre sur le substrat ; et

- des moyens de connexion électrique (9) insérés dans la fenêtre assurant une connexion étanche entre le circuit de détection et des éléments de traitement extérieurs à la cavité.

Elle concerne également le procédé de réalisation de ce dispositif.



FR 2 816 447 - A1



DISPOSITIF DE DETECTION
DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES TRIDIMENSIONNEL
ET PROCEDE DE REALISATION DE CE DISPOSITIF

5

DESCRIPTION

Domaine de l'invention

L'invention concerne un dispositif de
10 détection de rayonnements électromagnétiques, comme des
rayonnements infrarouges, dans lequel les détecteurs et
le circuit de lecture sont insérés dans une cavité sous
vide, fermée par une fenêtre transparente aux
rayonnements électromagnétiques, permettant des
15 connexions électriques étanches vers l'extérieur.

L'invention concerne aussi un procédé de
réalisation de ce dispositif.

L'invention se rapporte au domaine des
détecteurs thermiques et, en particulier, des
20 détecteurs infrarouges thermiques non refroidis. Elle
peut être utilisée, par exemple, dans des imageurs
infrarouges monolithiques fonctionnant à température
ambiante, et fabriqués à partir d'une matrice
d'éléments sensibles connectée à un circuit de
25 multiplexage en silicium de type CMOS ou CCD.

Etat de la technique

Les détecteurs thermiques non refroidis
30 comportent généralement un élément sensible pouvant
être chauffé par un rayonnement infrarouge dans la

bande 8 à 12 μm , cet élément sensible étant caractéristique de la température et de l'émissivité des corps observés. L'augmentation de température de l'élément sensible engendre une variation d'une 5 propriété électrique du matériau sensible ; cette propriété peut être, par exemple, l'apparition de charges électriques par effet pyroélectrique, ou bien la variation de la capacité par changement de la constante diélectrique, ou encore la variation de la 10 résistance lorsque le matériau est semi-conducteur ou métallique.

Pour que de tels détecteurs fonctionnent de façon optimale, trois conditions principales sont nécessaires. Le matériau sensible doit avoir une faible 15 masse calorifique, une bonne isolation thermique de sa couche active vis-à-vis de son support et une forte sensibilité de l'effet de conversion de l'échauffement en signal électrique, les deux premières conditions nécessitant une réalisation du matériau sensible en 20 couche mince.

Dans de nombreuses applications, telles que des applications à l'imagerie infrarouge, les détecteurs thermiques doivent être conditionnés sous vide ou sous un gaz non conducteur de la chaleur pour 25 gagner en performance. Dans ce cas, les détecteurs thermiques sont encapsulés dans un boîtier comportant une fenêtre transparente dans la bande III, c'est-à-dire la bande de 8 à 12 μm . L'opération classique d'encapsulation en boîtier est délicate, en 30 terme de rendement, et relativement coûteuse. Pour

diminuer le coût de cette intégration, des méthodes d'encapsulation collective sont proposées.

Une de ces méthodes d'encapsulation collective est décrite dans le brevet WO-95/17014. Il 5 s'agit d'une méthode d'encapsulation collective sous vide (ou sous un gaz non conducteur de chaleur) par couplage d'une tranche de détecteurs avec une tranche de fenêtres transparentes au rayonnement infrarouge. La liaison entre les deux tranches est réalisée par un 10 cordon de soudure qui, d'une part, assure l'étanchéité de l'ensemble et, d'autre part, permet le passage de la connexion électrique entre l'intérieur et l'extérieur du dispositif. Ce cordon de soudure détermine aussi, en fonction de son épaisseur, l'écartement entre les deux 15 composants du boîtier. L'écartement peut également être réalisé par une entretoise générée à partir de couches déposées sur la tranche de dispositif ou la tranche de fenêtre, ou encore directement élaborée dans le matériau de la fenêtre. Pour des composants de grandes 20 dimensions, un pilier peut être placé au centre, afin de limiter les déformations des composants de grandes dimensions.

La méthode décrite dans ce document propose de placer une couche métallique du côté de la tranche 25 de détecteurs et du côté de la tranche de fenêtres pour assurer la mouillabilité et l'accrochage de la soudure.

D'autre part, le maintien du vide à l'intérieur du microboîtier, est assuré en employant des matériaux qui ne présentent pas un taux de dégazage 30 excessif. Cependant, même avec un taux de dégazage relativement faible, il est quasi obligatoire

d'utiliser un matériau getter pour absorber les gaz émis par les différentes surfaces, car l'accroissement de la pression dégrade l'isolation thermique des microponts. Ce matériau getter peut être du baryum, du 5 vanadium, du fer, du zirconium ou des alliages de ces matériaux. Cependant, avant d'être actifs, de tels matériaux doivent être activés à haute température, pendant une courte période, soit par effet Joule, soit par un faisceau laser, sans toutefois que le détecteur 10 et la fenêtre soient chauffés outre mesure. Pour résoudre ce problème, le matériau getter est déposé sur des microponts réservés à cet usage, ceci dans le but de confiner l'échauffement uniquement au matériau getter.

15 Sur la figure 1A, on a représenté schématiquement ce procédé de réalisation collective de dispositifs de détection infrarouge.

Cette figure 1A montre une tranche de détection 2, une tranche de fenêtres transparentes aux 20 rayons infrarouges 3, et des microbolomètres, c'est-à-dire des détecteurs infrarouges non refroidis, référencés 4a, 4b, 4c. Cette figure 1A montre également que la tranche de détection 2 et la tranche de fenêtre 3 sont séparées à intervalles réguliers par des 25 entretoises 5a, 5b, 5c, 5d, etc., qui assurent la séparation des différents dispositifs de détection.

30 L'ensemble représenté sur la figure 1A est ensuite coupé entre deux entretoises, par exemple entre 5b et 5c, pour former différents dispositifs de détection infrarouge.

Par ailleurs, un dispositif de détection infrarouge à fenêtre en silicium est décrit dans la demande de brevet GB-A-2 310 952. Réaliser la fenêtre transparente aux rayons infrarouges, en silicium, présente des avantages, à savoir un coût peu élevé et une bonne compatibilité, en terme de coefficient de dilatation, avec le circuit de détection fabriqué également sur un substrat de silicium. En outre, le silicium permet d'obtenir un bon compromis entre les propriétés mécaniques et les propriétés optiques du dispositif.

Pour assurer l'assemblage de la fenêtre avec le circuit de détection, ce document propose d'effectuer soit un scellement eutectique, soit un scellement par verre fritté à bas point de fusion, soit une soudure par thermocompression. Dans le cas du scellement eutectique, il est proposé d'utiliser des alliages étain/plomb pour le scellement, et une tricouche W/Ni/Au pour les métallisations d'accrochage.

Sur la figure 1B, on a représenté schématiquement le dispositif de détection infrarouge décrit précédemment, après découpe à l'extérieur des entretoises 5c et 5d.

Ce dispositif de détection infrarouge comporte un circuit de détection comprenant les détecteurs 4a et 4b et des circuits de lecture, et une fenêtre transparente aux rayons infrarouges 3. La fenêtre 3 est maintenue au-dessus du circuit de détection 2 par l'intermédiaire de deux entretoises 5c et 5d. L'ensemble de ce dispositif est alors fixé sur

un support 6, auquel il est connecté par des fils d'interconnexion 7.

Un tel dispositif nécessite des cordons de scellement 5' sur le circuit de détection 2, qui 5 permettent le passage de la connexion électrique entre le circuit de détection 2 et les moyens de traitement extérieurs au dispositif, après isolation électrique de ces connexions. Or, l'introduction de tels cordons dans le procédé de réalisation est extrêmement délicate car 10 elle nécessite la présence d'or, qui présente le risque de contaminer le circuit CMOS du circuit de détection 2.

De plus, ce cordon de scellement accroît la taille du circuit de détection qui constitue l'élément 15 le plus onéreux du dispositif final. La topologie au niveau du joint de scellement 5' doit être considérablement réduite, c'est-à-dire qu'elle doit être planarisée, par polissage mécanochimique pour assurer un scellement hermétique.

20 En outre, comme expliqué précédemment, il est nécessaire d'utiliser des getters dans ce dispositif, afin d'assurer le maintien du vide à l'intérieur du dispositif, entre le circuit de détection 2 et la fenêtre 3. Or, ces getters sont 25 placés à côté des détecteurs infrarouges, augmentant encore la surface du circuit de détection 2, au détriment du nombre de circuits de détection par tranche.

Exposé de l'invention

L'invention a justement pour but de remédier aux inconvénients du dispositif et du procédé de réalisation décrits précédemment. A cette fin, elle propose un dispositif de détection de rayonnements infrarouges réalisé en trois dimensions, de façon à transférer la partie relative au scellement sur des éléments nettement moins coûteux que les circuits de détection et de façon à loger le getter en dessous du circuit de détection.

De façon plus précise, l'invention concerne un dispositif de détection de rayonnements électromagnétiques comprenant au moins un détecteur thermique non-refroidi et un circuit de lecture, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un substrat formant une cavité sous-vide, dans laquelle sont placés le détecteur thermique et le circuit de lecture ;

- une fenêtre transparente aux rayonnements, placée au-dessus de la cavité et assurant la fermeture de celle-ci ;

- des moyens de fermeture pour fermer hermétiquement la fenêtre sur le substrat ; et

- des moyens de connexion électrique insérés dans la fenêtre assurant une connexion étanche entre le circuit de détection et des éléments de traitement extérieurs à la cavité.

Avantageusement, le dispositif comporte un getter placé dans la cavité, en dessous du circuit de lecture.

Selon un mode de réalisation de l'invention, les moyens de connexion sont des orifices métallisés.

5 Selon un autre mode de réalisation de l'invention, les moyens de connexion sont des plots métalliques sensiblement en forme de H et traversant de part en part la fenêtre.

10 Dans une variante de l'invention, les moyens de fermeture consistent en un scellement anodique.

Dans une autre variante, les moyens de fermeture consistent en un scellement eutectique.

15 L'invention concerne également un procédé de réalisation de ce dispositif. Plus précisément, il s'agit d'un procédé d'encapsulation de détecteurs thermiques non refroidis, associés à au moins un circuit de lecture et destinés à détecter des rayonnements électromagnétiques. Ce procédé se caractérise par le fait qu'il consiste à :

20 a) réaliser une cavité dans un substrat ;
b) réaliser des orifices dans une fenêtre transparente aux rayonnements à détecter et insérer, de façon étanche, des moyens de connexion électrique dans les orifices de la fenêtre ;
25 c) connecter le circuit de détection à la fenêtre transparente par l'intermédiaire des moyens de connexion ; et
d) placer le circuit de détection dans la cavité et sceller hermétiquement la fenêtre transparente sur le substrat.

Avantageusement, le procédé de l'invention comporte une étape c', qui consiste à placer un getter dans la cavité, avant de placer le circuit de détection.

5 Avantageusement, on dépose une couche anti-reflet de part et d'autre de la fenêtre transparente.

10 Selon un mode de réalisation de l'invention, les détecteurs sont montés sur n circuits de lecture, avec $n \geq 2$. Dans ce cas, le procédé de l'invention consiste à :

- réaliser n fois l'étape a) dans une tranche de substrats ;

15 - réaliser n fois l'étape b) dans une tranche de fenêtres transparentes ;

- réaliser n fois l'étape c) dans ladite tranche de fenêtres ;

- réaliser l'étape d) pour chaque cavité ;

et

20 - découper l'ensemble formé de la tranche de fenêtre et de la tranche de substrat pour obtenir n dispositifs de détection conformes à celui de la revendication 1.

25 Brève description des figures

- La figure 1A, déjà décrite, représente schématiquement l'étape générale du procédé de fabrication collective du dispositif de l'art antérieur ;

- la figure 1B représente le dispositif de l'art antérieur obtenu par le procédé de la figure 1A ;

- la figure 2 représente le dispositif de détection de rayonnements infrarouges de l'invention ;

5 et

- la figure 3 représente schématiquement les différentes étapes de réalisation du dispositif de la figure 2.

10 Description détaillée de modes de
réalisation de l'invention

Sur la figure 2, on a représenté schématiquement le dispositif de détection de 15 rayonnements infrarouges selon l'invention. Les références portées sur la figure 2, qui sont similaires à celles portées sur les figures 1A et 1B, représentent des éléments identiques.

Le dispositif de l'invention se présente 20 sous la forme d'un empilement d'éléments dans trois dimensions. L'un de ces éléments est un circuit de détection 2, qui comporte un circuit de lecture et trois détecteurs infrarouges non refroidis 4a, 4b et 4c, qui sont appelés aussi « microponts » et qui sont 25 connectés au circuit de lecture. Le nombre de détecteurs peut être élevé (par exemple 256 x 256).

Lorsque le dispositif de détection est appliqué à l'imagerie infrarouge, chaque micropont représente un pixel de l'image détectée.

Le circuit de détection 2 est placé à l'intérieur d'un substrat 8 creusé de façon à former une cavité 10.

Un autre élément de l'empilement 3D est une 5 fenêtre transparente aux rayonnements infrarouges, référencée 3, et placée au-dessus de la cavité 10, de façon à assurer la fermeture de la cavité 10. Cette fenêtre transparente 3 repose sur les parois 8a et 8b de la cavité 10. Elle est fixée sur ces parois, par un 10 scellement, par exemple de type anodique, comme représenté par la référence 12 sur la figure 2. Cette fenêtre 3 peut également être fixée sur les parois de la cavité 10 par un scellement de type eutectique, comme représenté par la référence 13. On comprendra, 15 bien sûr, que lors de la réalisation d'un tel dispositif, on réalise le scellement de la fenêtre sur le substrat 8 (c'est-à-dire sur les parois 8a et 8b de la cavité 10) par un même type de scellement, à savoir un scellement anodique ou un scellement eutectique.

20 La fenêtre transparente 3 est percée de plusieurs orifices laissant traverser les moyens de connexion entre l'extérieur du dispositif et l'intérieur de la cavité.

Dans le mode de réalisation de la figure 2, 25 la fenêtre transparente aux rayons infrarouges comprend deux orifices, référencés 3a et 3b, permettant le passage des moyens de connexion 9 à travers la fenêtre 3. Les orifices peuvent être métallisés par un procédé de sérigraphie ou bien par décomposition thermique 30 (procédé LPCVD). De préférence, l'épaisseur de ces couches métallisées est comprise entre 0,5 µm et 5 µm.

Les moyens de connexion 9 assurent le maintien du circuit de détection 2 à l'intérieur de la cavité 10.

Ils assurent, par conséquent, le 5 positionnement des détecteurs infrarouges 4a, 4b et 4c par rapport à la fenêtre. Ces moyens de connexion 9 permettent, d'autre part, le passage étanche d'une connexion électrique étanche entre le circuit de détection 2 contenu dans la cavité 10 et des moyens de 10 traitement 20 extérieurs au dispositif. Ces moyens de traitement électrique extérieurs 20 peuvent être, par exemple, une carte électrique 20a connectée, par l'intermédiaire de plots de soudure 20b, à un ou plusieurs moyens de connexion 9 du dispositif de 15 détection.

Les moyens de connexion électrique 9 peuvent être de différents types. Toutefois, il est nécessaire que ces moyens de connexion soient suffisamment rigides pour permettre la fixation 20 mécanique du circuit de détection 2, afin d'assurer une position stable à ce circuit à l'intérieur de la cavité et qu'ils soient étanches de façon à assurer le vide à l'intérieur de la cavité 10. Il est à noter que l'on 25 parlera, dans toute la description et les revendications, de « cavité sous vide », étant entendu qu'il peut s'agir aussi d'un gaz peu conducteur de chaleur.

Ces moyens de connexion 9 peuvent, par exemple, consister en des plots métalliques 9a ayant 30 sensiblement une forme de H renversé et traversant de part en part la fenêtre (ils seront appelés, par la

suite, plots métalliques en H). Mais toute technique utilisant des trous métallisés totalement ou partiellement comblés peut aussi convenir.

Ces moyens de connexion comportent 5 également des plots métalliques de connexion 9c, fixés sur le circuit de détection 2 (appelés plots métalliques plats). Des plots d'hybridation, référencés 9b, assurent le lien mécanique et la connexion électrique entre les plots métalliques en H 9a et les 10 plots métalliques plats 9c. Ces plots 9a, 9b et 9c sont réalisés en des matériaux métalliques, tels que du Ti, TiN, Pt, Al, Au, W, Ni, Ln, Sn, MnPb, SnPb, etc.. Ils sont déposés sur le dispositif par pulvérisation cathodique, CVD, ou bien par procédé d'évaporation:

15 Le dispositif de l'invention présente l'avantage de comporter une cavité suffisamment profonde pour permettre d'installer un getter à l'intérieur du dispositif, sous le circuit de détection 2. Sur la figure 2, on a représenté un getter 11, placé 20 sur un support de getter 11', éventuellement thermiquement isolant, en appui sur des décrochements 14 réalisés dans les parois 8a et 8b de la cavité. Le getter ainsi placé en dessous du circuit de lecture 2, permet un gain de place considérable par rapport aux 25 dispositifs classiques dans lesquels le getter est placé à côté du circuit de lecture. Le getter peut ainsi être de grande dimension et donc être utilisé comme micropompe, c'est-à-dire qu'il peut remplacer partiellement un dispositif de pompage secondaire, en 30 général extérieur à l'ensemble à pomper.

En outre, cet emplacement du getter, en regard de la face arrière du circuit de lecture 2, évite les risques d'altération des détecteurs 4a, 4b, 4c lors du scellement, puisque le getter n'est pas en contact direct avec le circuit de détection.

Dans le dispositif de l'invention, le scellement de la fenêtre 3 sur le substrat 8 peut être un scellement anodique ; celui-ci implique l'utilisation de verre, de type PYREX® (borosilicate), fortement dopé avec du sodium ou du potassium. L'ensemble à encapsuler est alors placé sous vide à une température, comprise typiquement entre 100 et 500°C, et en présence d'un champ électrique élevé, de l'ordre de 7×10^6 V/m dans le verre. La durée de l'opération peut atteindre 30 minutes environ. Or, sous l'effet conjugué du champ électrique et de la température, les ions migrent vers l'anode et la cathode où ils sont piégés. Les ions, ainsi accumulés, créent un champ électrique interne important qui assure l'adhésion des deux matériaux en présence. Toutefois, il est connu que les circuits CMOS (comme c'est le cas pour le circuit de lecture) sont sensibles à la diffusion de tels ions métalliques et au fort champ électrique. Mais, dans l'invention, le circuit de détection 2 est « suspendu » dans la cavité par l'intermédiaire des moyens de connexion 2 ; le scellement anodique se fait donc entre la fenêtre 3 et les parois 8a et 8b de la cavité 10, sans risque de toucher le circuit de détection 2. Ainsi, le champ électrique nécessaire au scellement est confiné à l'extérieur du circuit de détection ; il ne risque donc pas de le dégrader.

Dans le dispositif de l'invention, il est également possible de sceller la fenêtre 3 sur le substrat 8 par un scellement eutectique. Ce type de scellement consiste à introduire une couche métallique, 5 par exemple de l'or, entre deux surfaces de silicium, c'est-à-dire une couche d'or 13 entre la fenêtre et les parois de la cavité, puis à chauffer l'ensemble. La température de fusion du mélange qui se forme par diffusion est plus faible que celle du métal ou du 10 silicium. Ainsi, l'or réagit avec le silicium à 363°C pour former l'eutectique AuSi.

Dans le dispositif de l'invention, le circuit de détection n'est jamais directement en contact avec le métal, par exemple l'or, utilisé pour 15 le scellement. Il n'y a donc aucun risque de contamination du circuit de détection par l'or.

En outre, dans ce dispositif, il n'y a aucun relief provenant de métallisation, c'est-à-dire de contacts métalliques traversant le cordon de 20 scellement pour aller vers l'extérieur. Le scellement eutectique peut donc être réalisé sans problème entre la fenêtre et les parois de la cavité.

Le scellement de la fenêtre sur les parois de la cavité peut aussi se faire à partir de verres à 25 bas point de fusion ou bien de colles ou encore par apport de brasure.

Pour réaliser le dispositif de l'invention, il est nécessaire d'activer le getter, ce qui consiste à le chauffer. Le chauffage peut être réalisé par le 30 passage d'un courant électrique ou bien par le chauffage de l'ensemble substrat/fenêtre, ou

avantageusement par laser. Cette activation laser est réalisée à travers le substrat qui doit être transparent autour de la longueur d'onde de fonctionnement du laser. L'utilisation d'un laser 5 balayé permet d'activer la surface maximum du getter 11, tout en évitant de trop chauffer les détecteurs thermiques. A cet égard, la face arrière du circuit de détection peut être munie d'une couche réfléchissant la lumière infrarouge émise par le getter lors de son 10 activation. Le support 11' du getter est alors réalisé dans un matériau thermiquement isolant. Ce procédé d'activation au laser permet d'atteindre une température supérieure à 500°C et, ainsi, d'obtenir une période d'activation de quelques minutes seulement.

15 L'activation peut également se faire par radiofréquence. Dans ce cas, le matériau constituant le getter 11 ou son support 11' peut être métallique. On effectue alors un chauffage par induction à partir de la face arrière du substrat formant la cavité. Ainsi, 20 une onde électromagnétique provoque la circulation de courants induits, qui engendrent, à leur tour, des pertes par effet Joule dues au courant de FOUCAULT. Afin de ne pas dégrader le circuit de détection pendant 25 la phase d'activation, l'épaisseur du getter et/ou de son support doit être adaptée de manière à réaliser un blindage efficace. Comme pour l'activation par laser, la face arrière du circuit de détection peut comporter une couche réfléchissante, de préférence non conductrice de l'électricité.

Le dispositif de l'invention, tel que décrit précédemment, peut être réalisé au moyen d'un procédé, dit « d'encapsulation des détecteurs thermiques non refroidis ». Comme représenté sur la 5 figure 3, ce procédé consiste, tout d'abord, à réaliser une cavité 10 dans un substrat 8 (étape E1), ce substrat étant, par exemple, en silicium ou en verre. Il consiste ensuite (étape E2) à réaliser des orifices 3a, 3b dans une fenêtre transparente aux rayons 10 infrarouges ; cette fenêtre peut être, par exemple, en silicium ou bien en germanium ou encore en ZnS. Son épaisseur dépend de sa nature et du format des détecteurs. Elle est comprise, de préférence, entre 100 µm et 2 mm.

15 Des moyens de connexion 9 sont ensuite insérés dans les orifices de la fenêtre (étape E3), de façon à permettre une connexion étanche.

Ensuite, le circuit de détection 2 est connecté sur la fenêtre transparente 3 par 20 l'intermédiaire des moyens de connexion 9 (étape E4). Le circuit de détection 2 ainsi fixé sur la fenêtre 3 est alors inséré dans la cavité 10 (étape E5). La fenêtre transparente 3 est scellée hermétiquement sur les parois 8a et 8b du substrat.

25 Dans le mode de réalisation préféré de l'invention, le procédé consiste à placer un getter 11 dans la cavité, par exemple en appui sur des décrochements 14 réalisés dans la cavité, et ce avant de placer le circuit de lecture. Le getter peut aussi 30 être réalisé directement dans le substrat au moment où ce dernier est élaboré pour former la cavité.

Une étape supplémentaire permet de réaliser un anti-reflet sur la fenêtre, par dépôt d'une couche anti-reflet de part et d'autre de la fenêtre transparente.

5 Le détecteur de l'invention peut également être réalisé, de manière collective. Plusieurs dispositifs sont alors réalisés simultanément. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir réalisé au préalable :

10 - une tranche de détection (circuits de détection) sur laquelle est connectée une pluralité de détecteurs infrarouges non refroidis et leur circuit de lecture ;

15 - une tranche de fenêtres infrarouges réalisées en Si, Ge ou ZnS, avec des connexions vers l'extérieur ; et

- une tranche de substrat avec des cavités et des getter.

20 La tranche de fenêtres et la tranche de substrats ont été préalablement élaborées, de façon séparée, en utilisant des techniques de microélectronique classiques. Autrement dit, les cavités dans la tranche de substrats et les orifices dans la tranche de fenêtres sont réalisés par des procédés de gravure chimique ou de gravure par plasma.

25 Ainsi, lorsque la tranche de fenêtre et la tranche de substrats ont été élaborées, on hybride la tranche de détection sur la tranche de fenêtre, qui a pu être préalablement traitée anti-reflet. Ensuite, les composants de la tranche de détection sont séparés par 30 des moyens classiques de découpe des circuits intégrés sur tranche. Le procédé de réalisation collectif

consiste alors à placer les getters à l'intérieur des cavités et à sceller hermétiquement la tranche de fenêtres sur laquelle est fixée la tranche de détection avec la tranche de substrats. Ce scellement peut se faire selon l'une des techniques décrites précédemment.

On effectue ensuite la découpe de l'ensemble en une seule passe. L'activation du getter peut être effectuée avant ou après découpe, de sorte qu'à l'issue de la phase d'activation, la pression résiduelle dans la cavité soit inférieure à 10 mTorr ($= 10^{-2}$ mbar).

Selon une variante, il est possible, pour augmenter le nombre de circuits de détection par tranche de substrat, de découper la tranche de circuits de détection et connecter collectivement les circuits de détection ainsi obtenus à la tranche de fenêtre et ensuite seulement de reporter, puis de sceller l'ensemble sur la tranche de substrat.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de détection de rayonnements électromagnétiques comprenant au moins un circuit de détection 5 comprenant un détecteur thermique non-refroidi (4) et un circuit de lecture associé (2), caractérisé en ce qu'il comporte :

- un substrat (8) formant une cavité sous vide (10), dans laquelle sont placés le détecteur 10 thermique et le circuit de lecture ;

- une fenêtre (3) transparente aux rayonnements, placée au-dessus de la cavité et assurant la fermeture de celle-ci ;

- des moyens de fermeture (12, 13) pour 15 fermer hermétiquement la fenêtre sur le substrat ; et

- des moyens de connexion électrique (9) insérés dans la fenêtre assurant une connexion étanche entre le circuit de détection et des éléments de traitement extérieurs à la cavité.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un getter (11) placé dans la cavité, en dessous du circuit de lecture.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens 25 de connexion sont des orifices métallisés (3a).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les moyens de connexion sont des plots métalliques (9a) sensiblement en forme de H, traversant de part en part 30 la fenêtre.

5. Dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de fermeture consistent en un scellement anodique (12).

5 6. Dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de fermeture consistent en un scellement eutectique (13).

10 7. Procédé d'encapsulation de détecteurs thermiques non-refroidis associés à au moins un circuit de lecture et destinés à détecter des rayonnements électromagnétiques, caractérisé en ce qu'il consiste à :

a) réaliser (E1) une cavité dans un substrat ;

15 b) réaliser (E2) des orifices dans une fenêtre transparente aux rayonnements à détecter et insérer (E3), de façon étanche, des moyens de connexion électrique dans les orifices de la fenêtre ;

20 c) connecter (E4) le circuit de détection à la fenêtre transparente par l'intermédiaire des moyens de connexion ;

d) placer (E5) le circuit de détection dans la cavité et sceller hermétiquement la fenêtre transparente sur le substrat.

25 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comporte une étape c) qui consiste à placer un getter dans la cavité, avant de placer le circuit de détection.

30 9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce qu'il consiste à déposer une couche anti-reflet de part et d'autre de la fenêtre transparente.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, dans lequel les détecteurs sont associés à n circuits de lecture, avec $n \geq 2$, caractérisé en ce qu'il consiste à :

5 - réaliser n fois l'étape a) dans une tranche de substrat ;

- réaliser n fois l'étape b) dans une tranche de fenêtre transparente ;

10 - réaliser n fois l'étape c) dans ladite tranche de fenêtre ;

- réaliser l'étape d) pour chaque cavité ;

et

15 - découper l'ensemble constitué de la tranche de fenêtre et de la tranche de substrat pour obtenir n dispositifs de détection conformes à celui de la revendication 1.

1 / 3

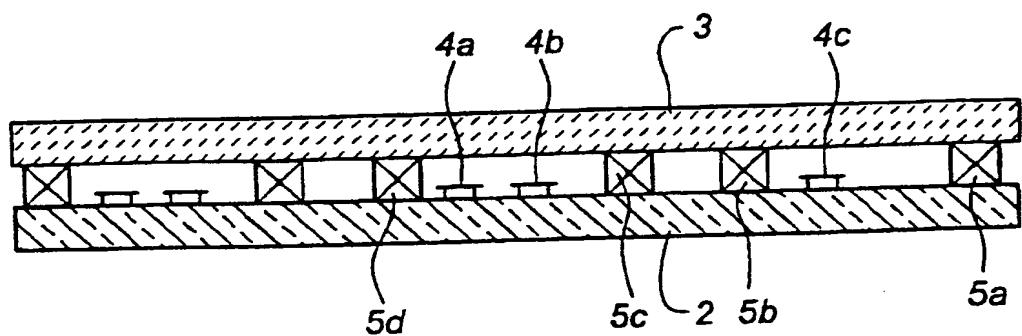


Fig. 1A

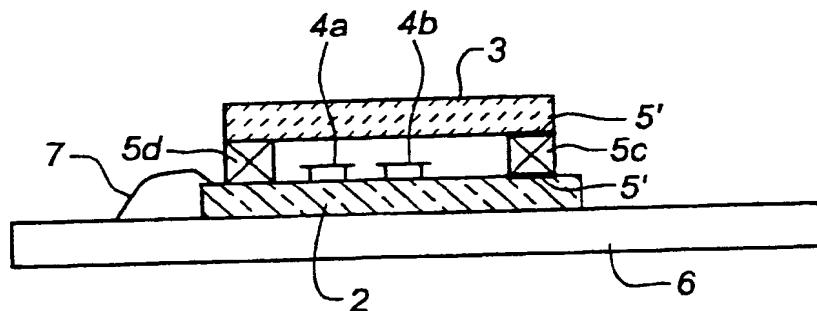


Fig. 1B

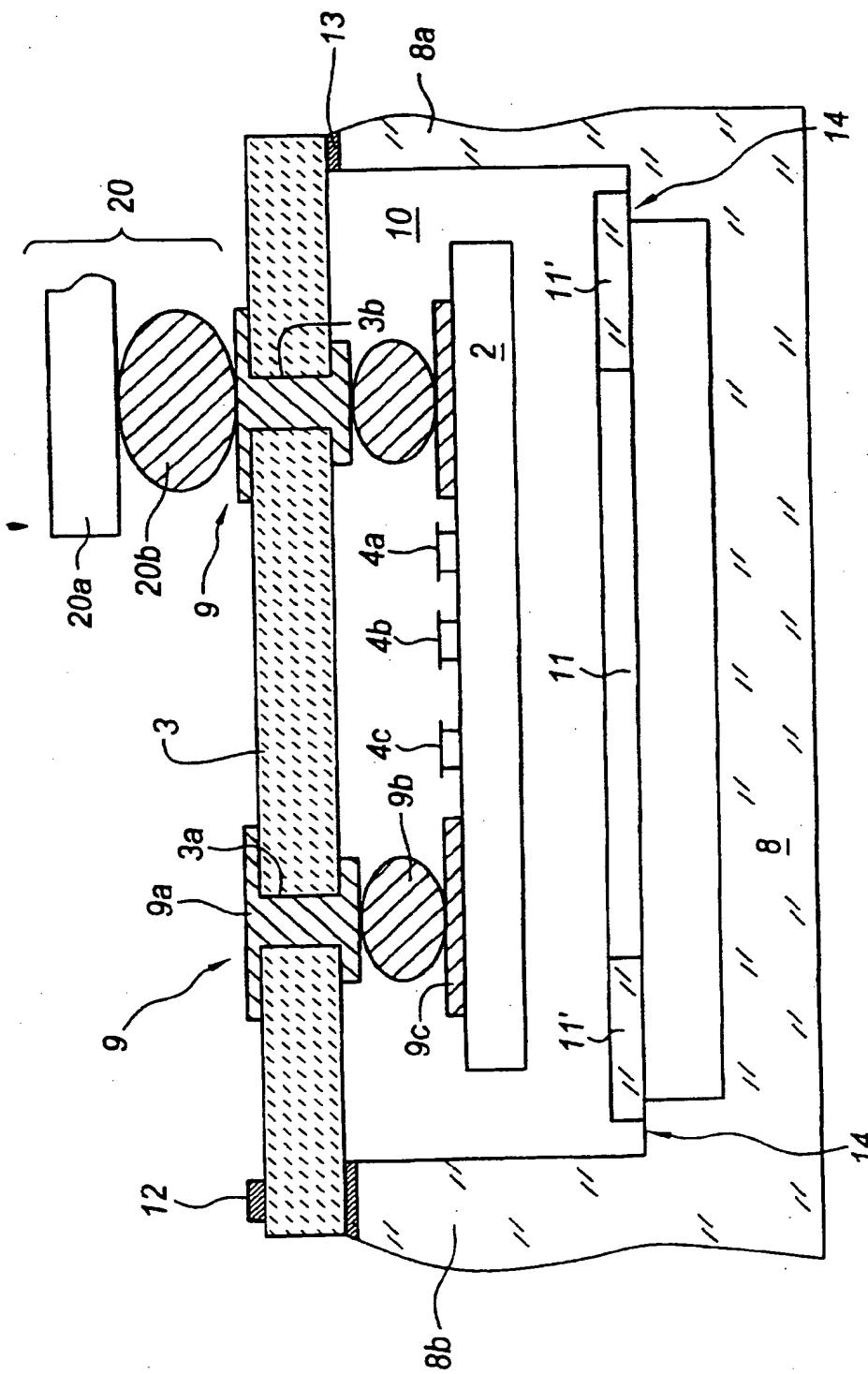


Fig. 2

3 / 3

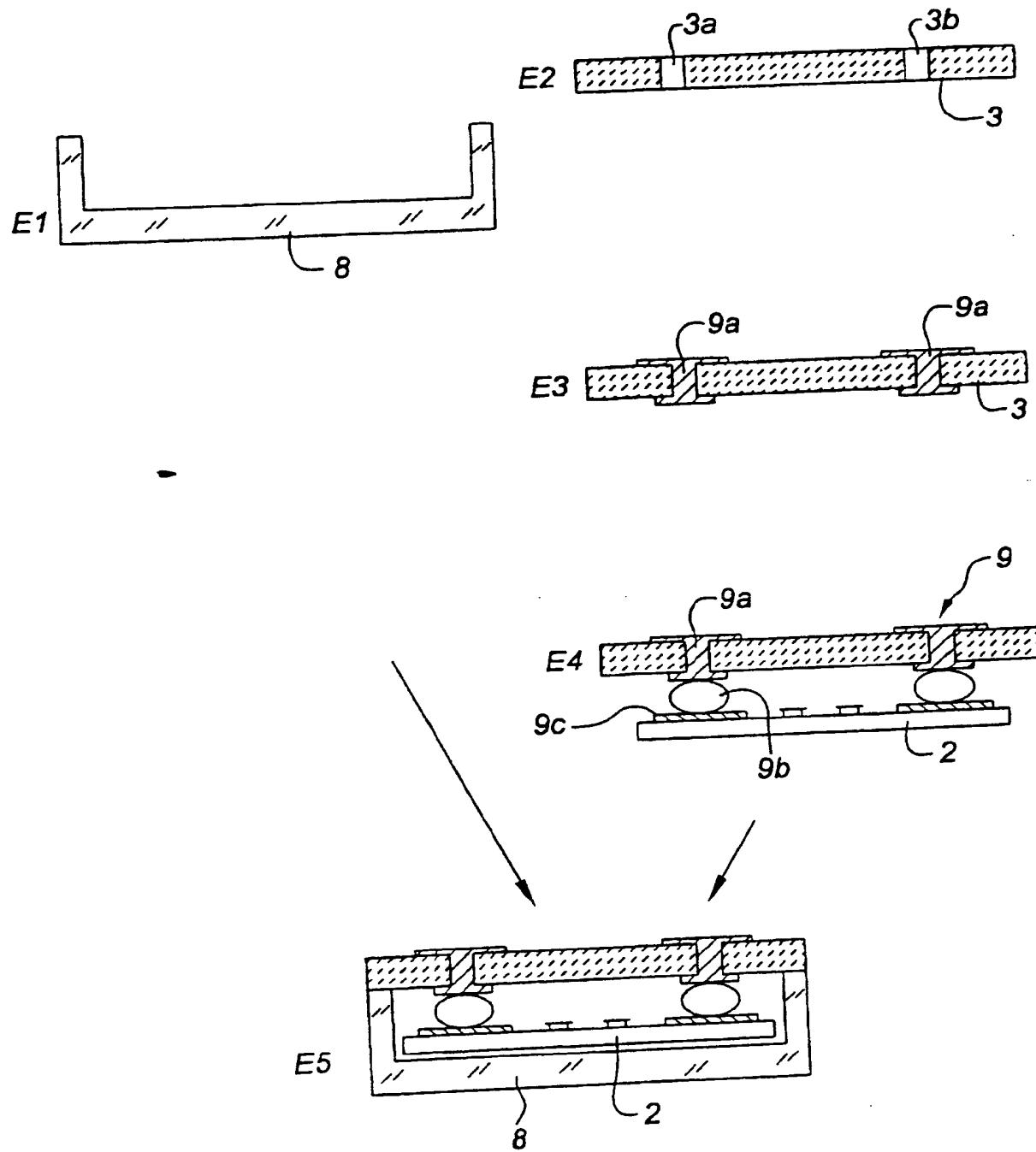


Fig. 3

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**
N° d'enregistrement
nationalFA 600564
FR 0014247établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
Y,D	WO 95 17014 A (HONEYWELL INC) 22 juin 1995 (1995-06-22) * revendication 10 * * figure 3 * * page 3, ligne 12 - ligne 25 * ---	1-4,6-8	H01L27/16 H04N5/33
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 13, 5 février 2001 (2001-02-05) -& JP 2000 298063 A (TDK CORP), 24 octobre 2000 (2000-10-24) * abrégé; figures 6-8 * ---	1-4,6-8	
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 10, 31 août 1999 (1999-08-31) -& JP 11 145489 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 28 mai 1999 (1999-05-28) * abrégé * ---	1,3,4,6, 7	
Y	WO 99 67818 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ; PORNIN JEAN LOUIS (FR); MASSIT CLAU) 29 décembre 1999 (1999-12-29) * figure 8 * * page 13, ligne 21 - page 14, ligne 9 * ---	1,3,4,6, 7	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.Cl.7) H01L G01J B81B
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 02, 30 janvier 1998 (1998-01-30) -& JP 09 264784 A (TERUMO CORP; KIMURA MITSUTERU), 7 octobre 1997 (1997-10-07) * abrégé * -----	1,5	
1	Date d'achèvement de la recherche 8 novembre 2001	Examinateur Visscher, E	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

THIS PAGE BLANK (USPTO)